

# 精选产品

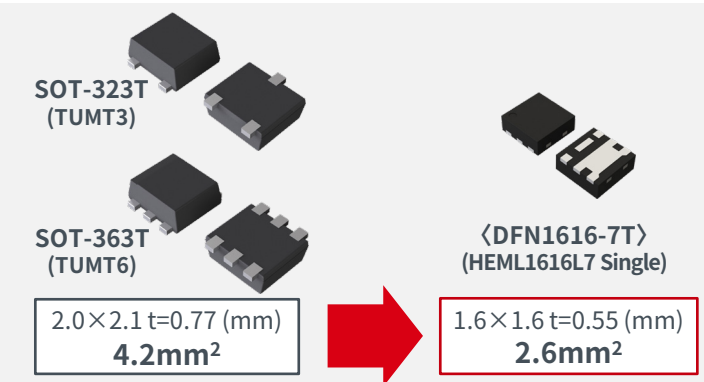


实现小型化和大电流! DFN1616/2020封装

## 小型移动设备用MOSFET

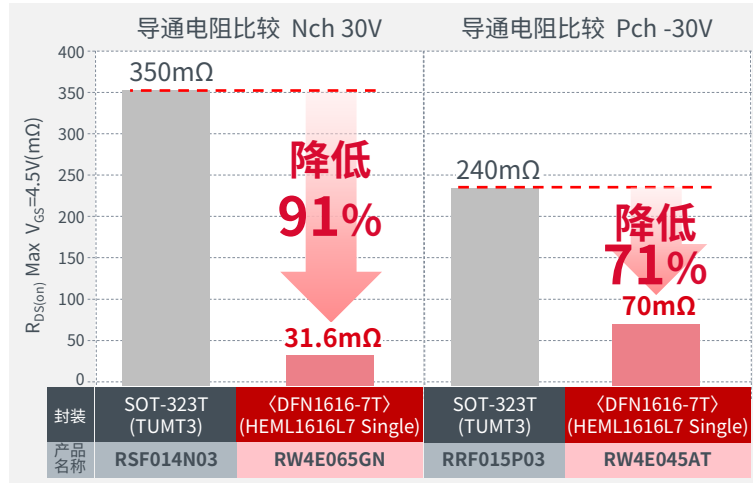
RW4xx系列 (Pw=1.5W DFN1616-7T) / RF4xx系列 (Pw=2W DFN2020-8S) / UT6xx系列 (Pw=2W DFN2020-8D)

**RW4xx系列的特点1**  
更小型, 更节省空间  
可用更小尺寸的封装进行设计!



通过更换封装, 安装面积可削减38%

**RW4xx系列的特点2**  
实现出色的低导通电阻(R<sub>DS(on)</sub>)



**小型移动设备用MOSFET的应用示例**


- 移动设备 (智能手机、便携游戏机)
- 小型设备 (平板电脑、电脑外围设备)
- 医疗保健设备 (剃须刀、可穿戴设备)



**使用电路**

LiB外围电路、负载开关等

### Rw4xx系列 产品阵容

产品名称	极性 (ch)	P <sub>w</sub> (W) T <sub>a</sub> =25°C	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A) T <sub>a</sub> =25°C	R <sub>DS(on)</sub> Max(mΩ)				Qg(nC) V <sub>GS</sub> =4.5V	封装
					V <sub>GS</sub> =10V	V <sub>GS</sub> =4.5V	V <sub>GS</sub> =2.5V	V <sub>GS</sub> =1.8V		
RW4E075AJ	N	1.5	30	7.5	—	26	38	—	6.3	 <DFN1616-7T> (HEML1616L7 Single) 1.6×1.6×0.55mm
RW4E045AJ			30	4.5	—	40	58	—	4.0	
RW4E065GN			30	6.5	22.5	31.6	—	—	2.1	
RW4C045BC	P	—	-20	-4.5	—	56	74	117	6.5	
RW4E045AT			-30	-4.5	48	70	—	—	5.3	

注: 封装采用JEDEC标准。 < > 内表示GENERAL代码, ( ) 内表示ROHM封装。

## 支持各种小型移动设备！ 小型和大功率(2W) DFN2020-8封装产品阵容

### 单极型：RF4xx系列（支持大电流，非常适用于电源电路开关）

产品名称	极性 (ch)	P <sub>w</sub> (W) T <sub>a</sub> =25°C	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A) T <sub>a</sub> =25°C	R <sub>DS(on)</sub> Max (mΩ)					Qg(nC) V <sub>GS</sub> =4.5V	封装
					V <sub>GS</sub> =10V	V <sub>GS</sub> =4.5V	V <sub>GS</sub> =2.5V	V <sub>GS</sub> =1.8V	V <sub>GS</sub> =1.5V		
RF4E100AJ	N	2.0	30	10	—	12.4	17.9	—	—	13	 (DFN2020-8S) (HUMML2020L8 Single) 2.0×2.0×0.6mm
RF4E110BN			30	11	11.1	15.4	—	—	—	12	
<b>New</b> RF4G100BG			40	10	14.2	23	—	—	—	5	
<b>New</b> RF4L070BG			60	7	27	40	—	—	—	3.9	
RF4C100BC	P		-20	-10	—	15.6	20	37.6	—	23.5	
RF4C050AP			-20	-10	—	26	31	45	65	55	
RF4E075AT			-30	-7.5	21.7	31.7	—	—	—	11	
RF4G060AT			-40	-6	40	51	—	—	—	8.5	
RF4L040AT		-60	-4	89	100	—	—	—	8.5		

注：封装的〈〉内表示GENERAL代码，( )内表示ROHM封装。

### 双极型：UT6xx系列（二合一封装，有助于进一步节省空间，驱动电压范围更广）

产品名称	极性 (ch)	P <sub>w</sub> (W) T <sub>a</sub> =25°C	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A) T <sub>a</sub> =25°C	R <sub>DS(on)</sub> Max (mΩ)					Qg(nC) V <sub>GS</sub> =4.5V	封装
					V <sub>GS</sub> =10V	V <sub>GS</sub> =4.5V	V <sub>GS</sub> =2.5V	V <sub>GS</sub> =1.8V	V <sub>GS</sub> =1.5V		
UT6K3	N+N	2.0	30	5.5	—	42	63	—	—	4.0	 (DFN2020-8D) (HUMML2020L8 Dual) 2.0×2.0×0.6mm
<b>New</b> UT6KB5			40	5	40	80	—	—	—	1.8	
<b>New</b> UT6KC5			60	3.5	95	145	—	—	—	1.7	
UT6JA3	P+P		-20	-5	—	59	76	118	—	6.5	
UT6J3			-20	-3	—	85	95	155	260	8.5	
UT6JA2			-30	-4	70	103	—	—	—	3.4	
UT6JB5	N+P		-40	-3.5	122	155	—	—	—	3.3	
UT6MA3			20	5.5	—	42	63	—	—	4.0	
		-20	-5	—	59	76	—	—	6.5		
UT6MA2		30	4	46	80	—	—	—	2.2		
		-30	-4	70	103	—	—	—	3.3		

注：封装的〈〉内表示GENERAL代码，( )内表示ROHM封装。



## 罗姆半导体集团

日本京都市右京区西院沟崎町21号  
邮编：615-8585

www.rohm.com.cn

本资料所记载的内容只是产品的情况介绍。要使用该产品时，请务必通过别的途径获取规格说明书，进一步确认产品的规格及其性能。本资料所记载的内容是力求准确无误而慎重编制的，但万一用户方出现因该内容存在错误或打字差错造成损失的情况，罗姆公司不予承担责任。本资料所介绍的技术内容是产品的典型工作状况和应用电路示例等，对于罗姆或其他公司的知识产权及其他所有权利未做明确的、暗示的准予实施或使用的承诺。如因使用这些技术内容而引发纠纷，罗姆公司不予承担责任。在输出本资料所介绍的产品及技术中符合「外国汇兑及外国贸易法」的产品或技术时，或者向国外提供时，必需取得依照该法发放的许可。

订购罗姆产品

本资料中的内容为截至2021年10月1日的信息。